

VORBEREITUNG VERSCHIEDENER UNTERGRÜNDE

CLAYTEC Lehmputze

- Vollständige Trocknung abwarten
- Größere Schwindrisse schließen
- Gesamte Flächen filzen oder schwammen bis feine Struktur erreicht ist
- **Besonders gutes Ergebnis durch Vorbereitung mit dünner Lage CLAYTEC Lehm-Oberputz fein**

CLAYTEC Pavaboard

- Fugen von mehr als 1-2 Breite und Schraublochvertiefungen mit CLAYTEC Lehmkleber vorspachteln
- Nach Trocknung Flächen 3 m dick mit Lehmkleber überziehen. CLAYTEC Glasseidengewebe gut in die nasse Oberfläche einarbeiten

CLAYTEC Lehmbauplatten

- Sorgfältige Fugen- oder Flächenarmierung nach Arbeitsblatt 5.2 oder 5.3
- Flächiger Überzug mit dünner Lage aus CLAYTEC Lehm-Oberputz fein

Alte Lehmputze, sonstige Lehmputze

- Vorbereitung nach Arbeitsblatt 6.1
- Zur Eignungsprüfung anderer Fabrikate Arbeitsprobe anlegen

Mineralische Altputze

- Tapeten- und Kleisterreste vollständig entfernen
- Auf durchschlagende Stoffe prüfen
- Beiputzarbeiten mit einem dem Altputzmörtel ähnlichen, mineralischen Mörtel

- Stark sandende Untergründe fixieren
- Problematische Bereiche ggf. teilarmieren
- Flächen grundieren

Beton

- Schalungsöle abwaschen
- Frische Betonflächen mit Sinterhaut und insbesondere Flächen, die mit dunklen oder kräftigen Tönen bearbeitet werden sollen fachgerecht flutieren
- Nur in Ausnahmefällen ausreichend planeben für direkten Farbputzauftrag, in diesen Fällen Vorbereitung mit CLAYTEC Universalgrundierung Feinkorn
- Andernfalls Vorbereitung mit Universalgrundierung und Lehm-Oberputz fein

Kunstharzgebundene Altputze

- Festigkeit prüfen
- Ggf. Rillen mit mineralischer Spachtelmasse auffüllen
- Vorbereitung mit CLAYTEC Universalgrundierung Feinkorn

Gipskarton- und Gipsfaserplatten

- Stabilität der Gesamtkonstruktion prüfen
- Platten müssen frei von Restfeuchte sein
- In jedem Fall Stöße armieren, z. B. selbsthaftendes Fugenband aufkleben, dann beim Spachtelfüllen zusätzlich Gazeband mit einspachteln.
- Herstellerangaben zur Stoßbehandlung beachten
- Spachtel gut trocknen lassen (3-4 Tage)
- Ebene Systeme mit flächiger

- Armierung z. B. Vlies vorbereiten, kein Flachs-, Jute- oder Glasgewebe
- Fläche vollständig und sorgfältig mit CLAYTEC Universalgrundierung Feinkorn grundieren. Dadurch neben Egalisierung der Saugfähigkeit auch Verbesserung der Griffigkeit und Schutz der Platten vor Feuchteaufnahme aus dem Putzauftrag
- Wenn notwendig flächiges Abspachteln der Gesamtkonstruktion

Poröse Dispersionsanstriche

- Festigkeit sorgfältig prüfen
- Sehr glatte Untergründe anschleifen
- Vorbereitung mit CLAYTEC Universalgrundierung Feinkorn

Glasgewebetapeten

- Festigkeit sorgfältig prüfen
- Bei ausreichender Griffigkeit Putzauftrag meist ohne Grundierung möglich (Arbeitsprobe). Andernfalls vorbereiten mit CLAYTEC Universalgrundierung Feinkorn

Sonstige nicht ebene Rohbauuntergründe und HWL-Platten

- Zweilagig verputzen. Grundlage aus CLAYTEC Lehm-Unterputz oder CLAYTEC Lehm-Oberputz fein
- Ausführung nach Arbeitsblatt 6.1

IN JEDEM FALL: ARBEITSPROBE ANLEGEN !

Alle Angaben zu Untergründen beruhen auf Erfahrungen. Im Einzelfall kann aufgrund verschiedener Aspekte (z. B. Griffigkeit, Saugverhalten, Festigkeit) ein abweichendes Vorgehen ratsam sein. **Es bedarf damit immer der Beurteilung des konkreten Untergrundes vor Ort, sie liegt in der Verantwortung des Ausführenden. Zum Zweck der Beurteilung muss stets eine ausreichend große Arbeitsprobe angelegt werden.** Die Arbeitsprobe dient auch der Überprüfung des Oberflächen- und Farbeergebnisses.